

高云GOWIN

广东高云半导体科技股份有限公司成立于2014年，是一家专业从事现场可编程逻辑器件（FPGA）研发与设计的国产FPGA高科技公司，致力于向客户提供从芯片、EDA开发软件、IP、开发板到整体系统解决方案的一站式服务。经过多年的积累，高云半导体在FPGA芯片架构、SOC芯片设计、FPGA集成EDA开发环境、FPGA通用解决方案等整个生态链均有核心自主知识产权，以及国内外发明专利。

通过最新工艺的选择和设计优化，高云半导体已经取得与现有市场国际巨头同类产品媲美的高质量、高可靠性FPGA产品，并已经在汽车、工业控制、电力、通信、医疗、数据中心等应用领域实现规模量产。

目前公司拥有员工200余人，在广州、上海、济南设有研发中心，随着公司业务在国内外市场的快速发展，公司规模一直在持续的扩张中。核心骨干拥有国际著名FPGA公司15年以上实战经验，亲历国内外数代FPGA芯片硬件、EDA软件、IP研发及市场、销售、技术支持等工作，是一支经验丰富、具备持续创新能力的务实团队。

公司于2015年一季度规模量产出产业化的55nm工艺400万门的中密度FPGA芯片，并开放EDA开发软件下载；2016年第一季度顺利推出国内首颗55nm嵌入式Flash SRAM的非易失性FPGA芯片；2017年实现FPGA芯片的规模出货；2019年，发布FPGA车规芯片，并实现规模量产。立足本土，布局全球市场，截止2021年，高云半导体实现三大系列：小蜜蜂（GW1N）、晨熙（GW2A）、ASSP GoBridge百余款FPGA及专用芯片在全球多个地区的规模量产。

本文链接：<https://dqcm.net/wenan/gygowin-763871.html>